

北京赛微电子股份有限公司
关于控股子公司 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目
完成竣工验收的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 6 月 2 日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）收到北京经济技术开发区行政审批局下发的《工程竣工验收备案表》[备案编号：0303 经竣 2021（建）0055 号]，赛莱克斯北京在北京经济技术开发区投资建设的“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”（FAB3）符合竣工验收的各项条件，同意项目竣工验收。

赛莱克斯北京是由公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资的 8 英寸 MEMS 国际代工线（FAB3）项目公司，主要从事 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）芯片的生产代工业务。赛莱克斯北京建设的该项目为公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目，该项目借鉴了公司瑞典子公司 Silex Microsystems AB（FAB1&FAB2）成熟的制造技术和生产管理模式，正在打造代表业界领先水平的 MEMS 产业化平台。该 8 英寸 MEMS 国际代工线设计总产能为 3 万片 MEMS 晶圆/月；一期产能为 1 万片 MEMS 晶圆/月，一期产能已于 2020 年 9 月建成并达到投产条件，自 2020 年第四季度至今持续进行产线的内部调试以及与合作客户进行工艺及产品验证。公司 FAB3 的陆续投产将开始为公司 MEMS 业务提供标准化的规模产能，与瑞典 Silex 进行协同互补，助力公司从 MEMS “精品工厂”向“量产工厂”转变，可进一步满足全球通信、生物医药、工业汽车、消费电子等各领域客户对 MEMS 工艺开发及晶圆制造不断增长的需求，增强公司在 MEMS 领域的全球市场竞争力。

公司北京 MEMS 产线为新建产线，从投产运行到良率提升、产能爬坡、全面达产尚需一定时间；且公司拟通过向特定对象发行股票募集资金继续投入进行后期扩产，对赛莱克斯北京经营业绩将产生综合影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日